

『공유재산 사용료 감면 동의안(지능형 반도체 기술지원 센터)』

검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 구 미 시 장

2. 제안이유

지역 중소기업에게 지능형 반도체관련 전문적 기술과 사업화를 지원하기 위한 '소프트웨어 기반지능형 SoC¹⁾/FPGA²⁾ 모듈화 지원' 사업의 주관 기관의 원활한 사업추진을 위하여 「공유재산 및 물품관리법」 제24조 및 같은 법 시행령 제13조, 제17조의 규정에 의거 구미전자정보기술원의 공유재산 사용료에 대하여 감면 동의를 받고자 함.

3. 주요내용

○ 지능형 반도체 기술지원 센터 사용료 감면

- 위 치 : 경북 구미시 구미대로 350-27, 스마트커넥트센터 5층
- 사용주체 : (재)구미전자정보기술원
- 감면기간 : 2021. 6. 1. ~ 2023. 12. 31.(2년 7개월)
- 사용면적 : 870.61㎡(전용면적 621.98㎡, 공용면적 248.63㎡)

1) SoC(System on Chip) : 여러 기능을 가진 시스템을 하나의 칩에 구현한 기술집약적 반도체
2) FPGA : 비메모리 반도체의 일종으로, 설계 가능한 논리소자와 프로그래밍이 가능한 내부선이 포함된 반도체 소자로서, 회로 변경이 불가능한 일반 반도체와 달리 목적에 따라 여러 번 회로를 다시 새겨 넣을 수 있는 반도체

4. 참고사항

○ 관계법령 : 「공유재산 및 물품관리법」 제24조 1항 4호, 「동법 시행령」 제13조, 제17조 5항 2의2호

○ 스마트커넥트센터 개요

- 위 치 : 구미시 구미대로 350-27, 금오테크노밸리 내
- 건 립 비 : 126억원(도 37.8, 시 88.2) ※ 준공일 : '20. 11. 13.
- 규 모 : 지상 5층, 지하 2층, 연면적 5,858.6m²
- 건축물 용도 : 교육연구시설
- 운영방법
 - 건물 운영 및 관리 : 구미시(신산업정책과) 직접운영
 - 지능형 반도체 기술지원 센터 운영 : 구미전자정보기술원(주관기관)

○ 소프트웨어기반 지능형 SoC/FPGA 모듈화 지원사업 개요

- 위 치 : 경북 구미시 구미대로 350-27, 스마트커넥트센터 5층
- 규 모 : 연면적 870.61m²
- 사업기간 : 2021. 4. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 총사업비 : 총 95.3억원(국비 40, 지방비 45.3, 민간 10)
- 사업내용 : 기술지원 센터 구축, 기술고도화 및 사업화 지원 등
 - 지능형 SoC모듈화 지원을 통한 제품기능 업그레이드 및 지능화

- 추진현황

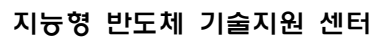
- 2020. 1. 6. : 신규 사업계획서 제출
- 2020. 1. 13. : '21년 스마트특성화기반구축사업 경북지역심의 선정
- 2020. 5. 1. : '21년 산업부 신규추진 적합사업 선정
- 2020. 10. 16. : SW기반 지능형 SoC 모듈화 지원사업 추진계획 수립
- 2021. 4. 6. : 산업부, '21년 신규사업 주관기관(구미전자정보기술원) 선정
- 2021. 4. 21. : 공유재산심의회 심의

- 향후추진계획

- 2021. 5월 : 공유재산 사용료 감면 의회 동의
- 2021. 6월 : 센터 구축 등 지원사업 추진

- 기대효과

- 새롭게 창출된 지능형 스마트 부품산업의 육성을 통한 관련 기업
신규 부가가치 창출 기회 제공
- 지역기업에서 보유한 부품기술과 국내외 IoT, AI 등 4차산업혁명
핵심기술과의 융합을 통한 기술경쟁력 강화



5. 검토의견

○ 본 「공유재산 사용료 감면 동의안(지능형 반도체 기술지원 센터)」는,

- '소프트웨어 기반 지능형 SoC³⁾/FPGA⁴⁾ 모듈화 지원' 사업의 주관 기관인 구미전자정보기술원이 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 지능형 반도체 기술지원 센터의 공유재산 사용료 7천8백여만원(연 사용료 3천만원)을 2021년 6월부터 2023년 12월말까지 2년7개월간 감면하는 것에 대해 의회 동의를 구하고자 제출된 동의안으로,
- 해당사업은 지역 중소기업에게 지능형 반도체 관련 전문적 기술과 사업화를 지원하기 위한 사업으로 중소기업 특화 지능형 부품 산업 육성을 통한 관련 기업의 신규 부가가치 창출에 기여할 것으로 기대 되어 사용료 감면이 타당하다고 판단됨.

3) SoC(System on Chip) : 여러 기능을 가진 시스템을 하나의 칩에 구현한 기술집약적 반도체

4) FPGA : 비메모리 반도체의 일종으로, 설계 가능한 논리소자와 프로그래밍이 가능한 내부선이 포함된 반도체 소자로서, 회로 변경이 불가능한 일반 반도체와 달리 목적에 따라 여러 번 회로를 다시 새겨 넣을 수 있는 반도체